第六次作业-回复与再结晶部分

张锦程 2018012082 材84

课本第10章课后习题1-9题,共9题

10-1 已知锌单晶体的回复激活能为 83736J/mol , 在 -50°C 温度去除 25% 的加工硬化需要 13d(天),若要求在 5min 内去除同样的加工硬化,需将温度提高多少?(提示:公式中 $R=8.3736J/(mol\cdot K)$,温度 T 的单位为 K)

由公式 $\ln \frac{t_1}{t_2} = \frac{Q}{R}(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2})$,代入数据计算可得:

$$ln\frac{13 \times 24 \times 60}{5} = \frac{83736}{8.3736} \left(\frac{1}{223} - \frac{1}{T_2}\right) \tag{1}$$

解得:

$$_2pprox 273.11K$$

10-2 有一块 Fe-3%Si 单晶如图 10-42 所示,为 BCC 晶体,长度为 3cm,其点阵常数 $a_0=0.3nm$,经弯曲变形后进行回复退火,发生多边形化过程,形成五块亚晶,由金相蚀坑法测得此时的刃位错总数 $n_T=1.128\times 10^6$,设其均匀分布构成亚晶界。

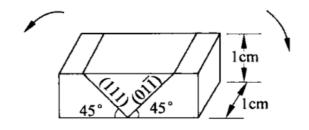


图 10-42 题 10-2 附图

- (1) 求相邻亚晶间的取向差。
- (2)设在多边形化前位错间无交互作用,问形成亚晶后畸变能与形成亚晶前相差多少?
- (3)由上述推测回复对再结晶有何影响。

提示:回复前后,位错线总长度不变,但单位长度位错线应变能有变化。由此可求出形成亚晶前后 畸变能的变化。

(1)亚晶界上位错距离
$$D=rac{b}{ heta}$$
 \Rightarrow 单位面积上的位错长度 $n=rac{ heta}{b}$ \Rightarrow

$$heta = nb = 2.248 imes 10^5 cm^{-1} imes 0.3 imes 10^{-7} cm imes rac{\sqrt{3}}{2} = 5.84 imes 10^{-3}$$

(2) 多边形化前:
$$E_1=rac{ heta}{b}rac{Gb^2}{4\pi(1-
u)}lnrac{R}{r_0}pprox 10 heta E_0$$
,其中 $E_0=rac{Gb}{4\pi(1-
u)}$

多边形化后: $E_2=E_0\theta(0.5-ln\theta)$ 所以 $\frac{\Delta E}{E_1}=\frac{E_2-E_1}{E_1}=\frac{0.5-ln\theta}{10}-1pprox 1-56.43\%=-43.57\%$

(3)回复后晶体的能量下降,更加稳定,亚晶界不易迁移,可能在一定程度上阻碍了此后的再结晶过程;但同时,形成的大曲率亚晶可作为再结晶的核心。

10-3 银的冷加工形变量为 26%,畸变能约为 16.7J/mol,银的界面能为 $0.4J/m^2$,观察到晶界移动的再结晶核心,弓出的品界长度(指弓弦长度)约为 $1\mu m$,问是否符合晶界弓出生核能量条件。(已知银的密度 $10.5g/cm^3$,摩尔质量 107.8g/mol)

计算得银单位体积的畸变能:

$$\Delta E_V = \frac{16.7}{107.8 \div 10.5} J/cm^3 = 1.62 J/cm^3 \tag{3}$$

则临界曲率半径:

$$L_{lim} = \frac{2\gamma}{\Delta E_V} = 0.4938\mu m \tag{4}$$

由于 $L \geq L_{lim}$,故符合晶界弓出生核的条件。

10-4 纯锆在 553℃ 和 627 ℃ 等温退火至完成再结晶分别需要 40h 和 1h , 试求此材料的再结品激活能。

由公式:

$$ln\frac{t_1}{t_2} = \frac{Q_R}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) \tag{5}$$

可得:

$$Q_R = R \ln(\frac{40h}{1h}) / (\frac{1}{826.15} - \frac{1}{900.15}) = 308.228kJ/mol$$
 (6)

10-5 设冷变形后位错密度 ρ 为 $10^{12}/cm^2$ 的金属中存在着加热时不发生聚集长大的第二相微粒,其体积分数 ${\bf f}={\bf 1}\%$, 半径为 ${\bf 1}\mu{\bf m}$, 问这种第二相微粒的存在能否完全阻止此金属加热时的再结晶 , 设 $G=10^5MPa$. $b=3\times 10^{-8}cm$, 比界面能 $\gamma=0.5J/m^2$ 。(提示:再结晶驱动力为 $p=Gb^2\rho$)

第二相粒子存在时对界面迁移产生的阻力为:

$$F_R = \frac{3f}{2r}\gamma = 7.5kPa \tag{7}$$

驱动力为:

$$Gb^2\rho = 9 \times 10^4 kPa \tag{8}$$

所以不能阻止此金属加热时的再结晶

10-6一块锡片在室温下弯曲,放置长时间后,其纵截面上组织如何变化,画图加以说明。已知锡的熔点为 232℃。锡片弯曲前后形状见图10-43.

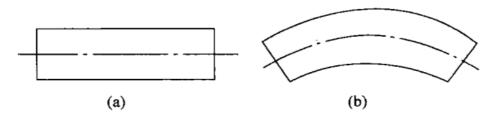
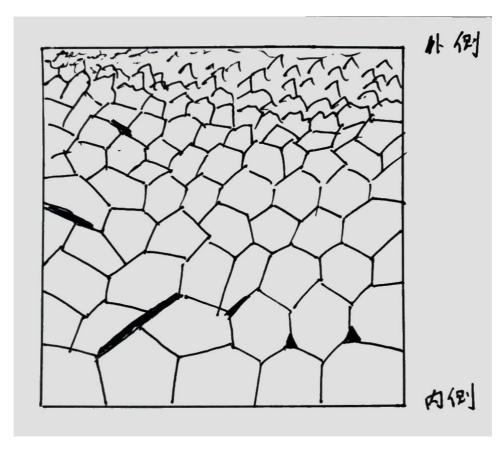
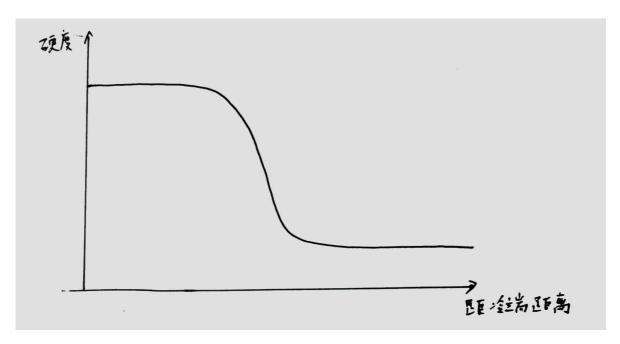


图 10-43 锡片弯曲前(a)后(b)形状

Sn 的熔点为 505~K,低温回复区: $50.5~K\sim151.5~K$ 、中温回复区 $151.5~K\sim252.5~K$ 、高温回复区: >252.5~K,可知室温属于高温回复区,可以发生多边形化过程,同时由于室温温度大于再结晶温度,所以会发生再结晶过程,回复对组织对影响较小,所以可以只考虑再结晶的影响; Sn 片外侧变形度大,内侧变形度小,大于临界变形度时,随着形变量的增大,晶粒尺寸减小,所以组织如下:



10-7 将经过大量塑性变形(如 70% 以上)的纯金属长棒的一端浸入冰水中,另一端加热至接近熔点的高温(例如 $0.9T_m$),过程持续进行一小时,然后试样完全冷却,试作沿棒长度的硬度分布曲线示意图,并作简要说明。



在热端,温度在再结晶温度之上,在冷端,温度显然在再结晶温度以下,在两端之间,由傅里叶传热定律,温度均匀变化,于是从冷端到热端依次发生回复-再结晶-晶粒长大这些过程。回复时由于缺陷密度的下降,硬度也部分下降;再结晶发生时,晶粒大小变化,导致硬度急剧下降;晶粒长大时,硬度也会继续下降。

10-8 将一楔形铜片置于间距恒定的两轧辄间轧制,如图 10-44所示。

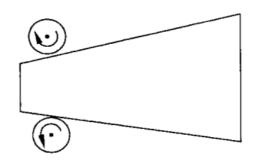
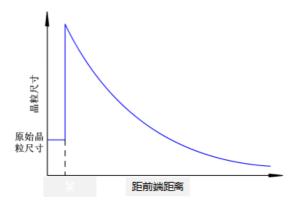


图 10-44 题 10-8 附图

- (1) 画出此铜片经完全再结品后品粒大小沿片长方向变化的示意图。
- (2) 如果在较低温度退火,何处先发生再结晶?为什么?
 - (1)形变量(预先变形度)由前段到后段依次增大,所以可画出下图:



(2)后端,因为后端的变形度较大,积攒的形变能较多,形核位置多,导致再结晶温度低,容易发生再结晶。

10-9 室温下枪弹击穿一铜板和铅板,试分析长期保持后二板弹孔周围组织的变化和原因。

铜的熔点较高,为1083.4℃ (1356.55 K),铅的熔点较低,为327℃ (600.15 K);枪弹的撞击,提供了巨大的初始形变量;对于铜来说,室温低于再结晶温度,主要发生低温回复,组织变化较小;对于铅来说,室温下已经可以发生再结晶和高温回复,变形的伸长晶粒变为新的等轴晶粒。